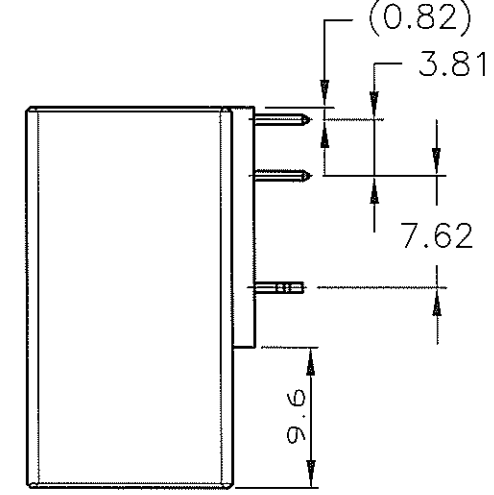
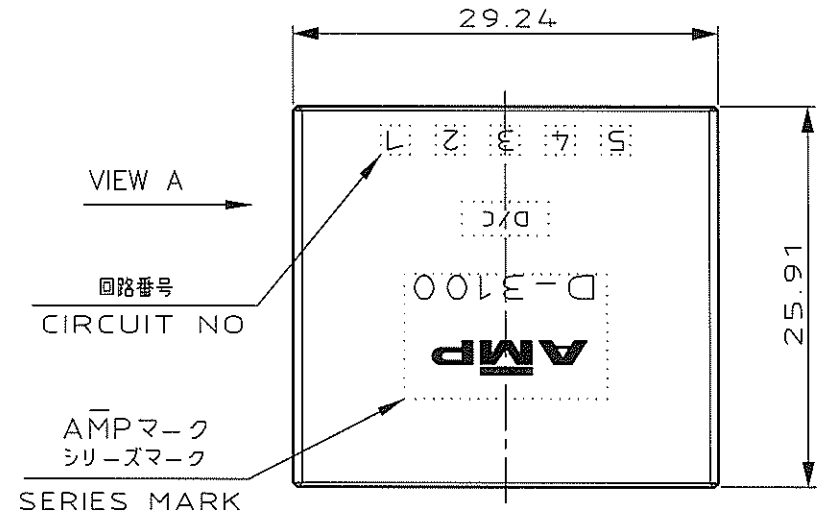
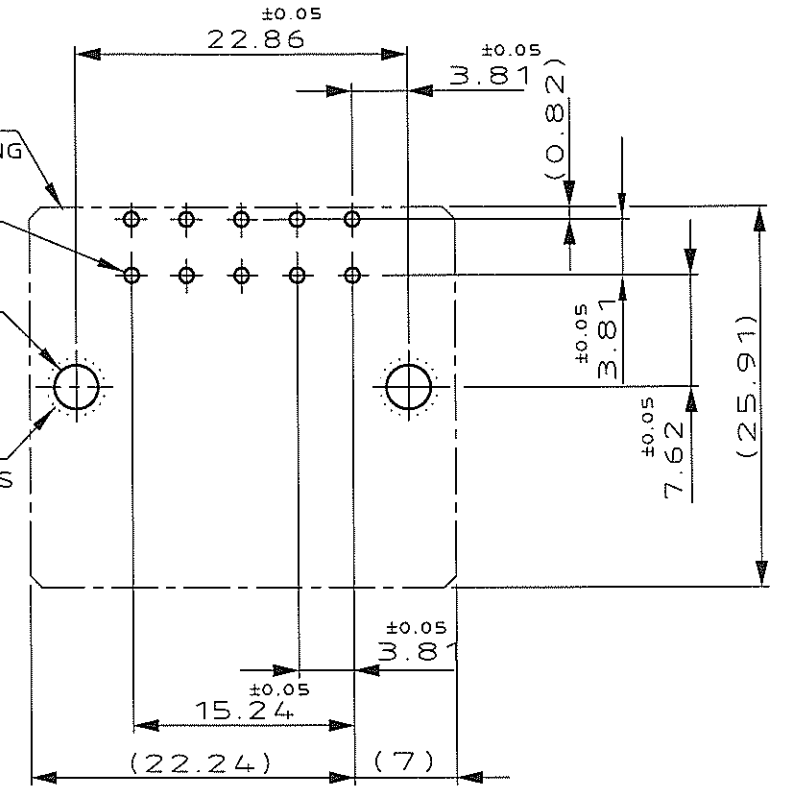


NUMBER 178305  
 METRIC  
 DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT  
 PRINT DIST

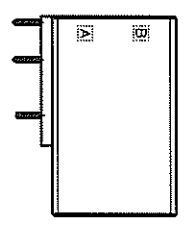
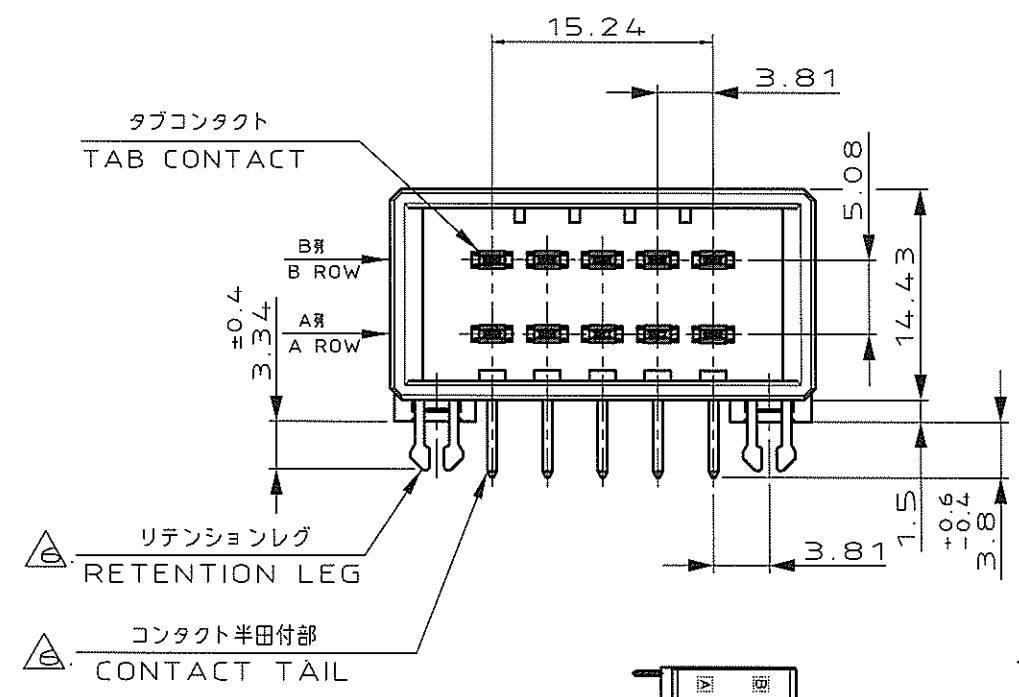


コネクタ外形  
 OUTLINE OF HEADER HOUSING  
 10-φ1.1  
 DIA 1.1±0.1 10PLACES  
 スルーホール 2-φ3  
 DIA 3±0.1 2PLACES  
 ラウンド 2-φ4MIN  
 ROUND DIA 4MIN 2PLACES



推奨基板取付け寸法  
 PC 基板厚: 1.6±0.1  
 (非累積公差)  
 (コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN  
 PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1  
 (NOT ACCUMULATE TOLERANCE)  
 (CONNECTOR MOUNT SIDE)



VIEW A (SCALE:1:1)

NOTES

- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILED THERMO PLASTIC, POLYESTER  
CONTACT: COPPER ALLOY  
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- FINISH (CONTACT AREA): 0.38μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 0.76μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注記

- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂  
コンタクト: 銅合金  
リテンションレグ: 銅合金
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地  
接触部: 0.38μm MIN金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地  
接触部: 0.76μm MIN金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地  
接触部: 2.0 μm MINスズめっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部  
ニッケル下地の上に半田めっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部: ニッケル下地の上にスズめっき

△6	△4	178305-5
△5	△3	178305-3
△6	△2	178305-2
(FINISH)		製品番号 (PART NO.)

C2	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	25APR11
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE

WIRE RANGE		INSULATION DIA		NAME	
mm²(AWG)		mm		ダイナミック D3100 水平タイプ 10 極 ヘッダーアセンブリー	
MATERIAL		FINISH		10 POS DOUBLE ROW HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC 3100	
SEE NOTE 注記参照		SEE NOTE 注記参照		一般公差 (GENERAL TOLERANCE): 10MF ±0.3 108MF ±0.4 308MF ±0.45 角 度 ±3'	
DR. 14 JUN 91 N. Matsubara		DE. 14 JUN 91 N. Matsubara		SIZE A3	LOC J
CHK. 7/00ata		APP. S. MANABE		NUMBER C-178305	SCALE 2-1
				REV. C2	SHEET 1 OF 1